

深圳市亿道信息股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-014

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（线上交流）
参与单位名称	长信基金、华安基金、中信诚保基金、人保资产
时间	2026年6月17日
地点	国金中心二期、工银大厦、世纪汇广场一座
上市公司接待 人员姓名	董事长 张治宇先生 副总经理、董事会秘书 乔敏洋女士 IR 谢蝶女士
交流内容及具体 问答记录	<p>1、公司今年一季度业绩增长的原因是什么？</p> <p>答：2026年一季度公司营收和净利润均呈现良好增长态势。主要得益于以下几个方面：</p> <p>一是近年来公司“AI+”战略持续深化落地，AI技术与终端产品深度融合。公司已构建覆盖个人、家庭、企业、工业、穿戴、机器人六大场景的“亿道AI智算解决方案矩阵”，产品结构持续优化，推动公司业绩增长。</p> <p>二是公司积极推进业务布局与市场拓展，订单量稳步增加，经营规模持续扩大。</p> <p>三是公司持续推动数字化建设，升级自有生产制造平台与供应链集采中心，提高生产效率和协同能力，同时通过精细化管理加强成本管控，整体盈利能力得到改善，利润实现同步提升。</p> <p>2、明年公司发展规划？</p>

	<p>答：All in AI，是公司的战略方向。公司秉持“让前沿科技更平易近人”的使命，致力于为客户提供具有竞争力的产品方案与服务。</p> <p>基于 AI 技术加速发展的趋势，深化 AI 在 AR、超算、工控等领域的应用落地，实现了向“场景智算体系构建者”的转型。</p> <p>公司持续升级生产制造能力，2025 年公司与华封科技合作发起亿封智芯先进封装项目，提前布局下一代技术路线，在系统级制造能力维度完成前瞻性布局。</p> <p>公司持续加大前沿技术领域的研发投入，以长期科技投入构建企业核心竞争力，亿道数字（研究院）自主研发的端侧推理框架（AESOF）已经应用于公司的 NAS、AI PC、一体机等产品中，有效解决跨平台跨系统端侧模型适配及推理效率问题，加速产品研发并提升产品性能。</p> <p>在 AI 应用端，公司与粤港澳大湾区数字经济研究院联手，共同建设 IDEA 亿道边缘计算人工智能实验室，聚焦 AI 模型在边缘计算领域的应用与发展，推动技术成果转化。</p> <p>公司持续深挖现有客户需求，助力国产品牌出海，积极导入国内外大客户，2025 年已逐步显现成效，未来将持续促进公司生产经营规模扩大。</p> <p>公司将依托在硬件制造领域的深厚积淀、对端侧部署复杂性的深刻理解，以及开放共建的生态理念，携手芯片巨头、存储伙伴、算法厂商、ISV（独立软件开发商）及开发者社区等合作伙伴，共同推进 AI 技术的普惠化进程。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作</p>	<p>无</p>

为附件)	
------	--